

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

# 芯联集成电路制造股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、中金公司、华泰证券、中欧基金等多家机构
时间	2024年05月30日 13:30-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 赵奇 财务负责人、董事会秘书 王韦 芯联动力董事长 袁锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>现场交流与问答：</b></p> <p><b>1. 公司一站式系统代工的经营模式，是否与上市时提出的一站式代工有变化？</b></p> <p>答：2023年，公司开始有了“系统方案”的具体业务落地，故而公司提出“一站式系统代工”的经营模式。这种模式，与一站式代工的差异为增加了提供系统代工解决方案的能力。这个变化并不是经营模式的变化，而是公司基于客户的需求对于经营模式的丰富和升级，来进一步提升公司与客户之间合作方式的灵活性和多样性，增加公司与客户合作的黏性。</p> <p><b>2. 公司海外客户拓展情况如何？出海市场有何动作和目标？</b></p> <p>答：公司2023年实现外销收入5.61亿元，同比增长42.58%。在海外出口业务中，汽车业务收入占比在2023年同样呈现大幅增长，并贡献了出口业务的主要增量。公司出口市场以日本和美国为主，公司主流产品的信价比在国际市场上具有较强的竞争力。</p>

**3. 请公司展开说一下公司第三增长曲线BCD业务，目前国内整体BCD的业务规模仍然较小，未来我们在BCD规划了多大的业务量，以及在新能源以及AI服务器电源方面，公司做了哪些准备？**

答:BCD市场是一个非常巨大的市场，全球大约400亿美元，国内的市场需求至少占一半。目前国内BCD业务存在两个瓶颈：1、通用性的BCD芯片份额非常少。占主导地位的是和应用方案高度融合的专业BCD；2、专业的BCD芯片需要特殊工艺，而国内基本只能提供普通工艺。这两个情况造成了国内BCD占比非常低，国产化率不足10%。

过去三年，公司联合终端产品应用和设计公司在车载、工控和消费领域针对性的开发了多个专业BCD平台。这些平台融合了公司对产品终端应用的深层次理解，定向性的给出了量身定制的特色工艺。目前，公司已经历了大范围高强度的开发阶段，开始进入大范围客户导入和产品导入、以及规模上量的阶段，2023年获得了多个重大定点。

电源管理一直是BCD的重要应用方向。AI等大算力芯片需要大量的电力消耗，能源使用效率成为AI应用的关键基础技术和前提条件，因此催生了面向大型GPU的高性能电源管理芯片的需求。过去三年，公司已经进行了两代技术更新。第一代已开始小规模量产，第二代55nm解决方案获得了关键客户重大定点。公司正全力扩大客户群、加速产品导入，BCD产品将会成为公司重大增长点之一。

公司非常有信心成为中国专业BCD的领先企业，也有信心实现中国BCD产业实现更大份额的国产化。

**4. 公司如何看待模拟IC的市场情况？公司模拟IC的差异化竞争优势是什么？预计收入增长主要来自哪些市场和客户？**

答:模拟IC赛道宽广，产品丰富。在车规级和工业级大电流高电压BCD方向，目前一直存在技术要求高、应用门槛高、国产替代比例非常低的情况。3年多来，公司持续发展了多个专用BCD平台，定向瞄准了一系列持续增长和供应稀缺的应用产品，拥有多项国内独有的技术。目前，公司已取得技术和市场的双突破，这些突破会不断的给公司未来营收和利润成长带来强大动力。

同时，公司也将推出消费类BCD技术，该技术具有极高的性价比和极强的通用性，为公司营收成长带来持续贡献。

我们对BCD、嵌入式数字技术和嵌入式功率器件的融合技术优势，联合国内外优秀设计公司和终端应用，大规模正面组织对这一市场的攻克。智能化新能源车车身架构的进一步发展和AI超大计算中心的建设将会为我们BCD业务

提出持续、大量的需求。

**5. 公司今年计划减亏，很高兴看到目前公司亏损在收窄，有什么措施保证全年实现减亏目标吗？**

2024年实现大幅减亏是公司明确的目标，我们主要从两个方面入手来实现这一目标。

第一，不断通过技术迭代和技术创新，实现技术的领先型和丰富化，并在这些领先和丰富的技术上实现更大的生产规模，贡献更大的营收。如，通过产品迭代，全球领先的新一代IGBT器件将在下半年进入量产，大幅提高同一晶圆上的芯片产出数量，从而实现营收的增长；通过SiC芯片和模组、模拟IC、VCSEL等新技术、新产品的上量等实现营收的增长，以及积极参与市场竞争，快速响应，扩大市场份额，提升产能利用率，增加营收。

第二，不断优化公司的成本结构。通过工艺步骤、工艺条件的优化来降低工艺平台的基础成本；通过生产效率的不断提升来提高单步工艺的竞争力；通过供应链上的战略合作和协同，公平竞争等，来降低材料和零部件的采购成本；通过精细化管理和信息数据、流程的系统化，设备的自动化等，来提高人员的工作效率、降低库存资金占用、减少各个方面的浪费。通过以上开源节流两个方向的努力，公司对实现2024年大幅减亏充满信心。

**6. 公司目前产能投资较高，对于这种快速的投资及扩产，公司如何把控其中的风险？何时公司能实现盈利？**

答：由于半导体行业高资产、高投入的特性，公司自2018年成立以来，恰逢赶上半导体行业市场需求的旺盛期，故而公司在前期投入期进行了较大规模的投资和扩产。

目前，公司已形成了较大的产能规模，公司的SiC产线、12英寸产线、模组产线等，将根据市场需求的变化，相对平稳的进行投资和扩产。

基于公司的营收的稳速增长及精益化的生产管理，随着折旧的逐渐消除，公司预计2026年实现盈利。公司着力于成本的管控，从多方面多角度对成本进行持续优化，力争能尽早实现盈利。

**7. 公司在材料端和设备端国产化率的程度及对未来如何展望？**

答：公司从4年多前就已经开始材料和设备国产化验证的工作。目前材料端在全品类方面都实现了国产化验证。在设备端，公司计划于2024年底前实现95%以上种类的设备的国产化验证。

附件清单（如有）	无
日期	2024年05月30日